

USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	データの最小化 - USBジャック, USB ジャック, 480 Mbps, SMDはんだ接続, 180°, ≥ 10000, ピッチ (mm) (P): 0.65 mm, 極数: 5, LCP, 黒色, Tape
注文番号	2762070000
種別	USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK
GTIN (EAN)	4064675035299
数量	2,000 Stück
パッケージ	Tape

作成日 2024/07/04 6:09:55 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	2.9 mm	奥行き (インチ)	0.114 inch
高さ	10.51 mm	高さ (インチ)	0.414 inch
幅	7.99 mm	幅 (インチ)	0.315 inch
正味重量	0.299 g		

システム仕様

LED	いいえ	PCB の取り付け	SMD はんだ接続
はんだピン位置の公差	0.1 mm	はんだピン寸法	八角形
はんだ付け工程	リフローハンダ付け, 手動 はんだ付け	シールド	はい
シールド材質	ステンレススチール	シールド面	ニッケルメッキ
ソルダーピン長 (l)	0 mm	ピッチ (mm) (P)	0.65 mm
ピッチ (インチ) (P)	0.026 "	プラグイン回数	≥ 10000
保護度合い	IP20	外向きエルボ	180°
差し込み力 / 極、最大	35 N	引張強度 / 極、最大	10 N
性能カテゴリ	480 Mbps	接続方式	ソケットコネクタ
極数	5	製品ファミリー	データの最小化 - USB ジャック
転送速度	480 Mbps		

電気プロパティ

体積抵抗	<25 mΩ	定格電圧	48 V
定格電流	1 A	絶縁耐性	≥ 100 MΩ
耐電圧、接点 / 接点	100 V AC		

材料データ

絶縁材	LCP	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	絶縁耐性	≥ 100 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	UL 94 可燃性等級	V-0
接点ベース素材	銅合金	接点材質	銅合金
接触表面	ニッケル下地金メッキ	プラグ接点の層構造	≤ 1 μ" Au
保管温度、最小	-40 °C	保管温度、最大	70 °C
動作温度、最小	-30 °C	動作温度、最大	80 °C

梱包

パッケージ	Tape	VPE 長	462 mm
VPE幅	450 mm	VPEの高さ	166 mm

分類

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

作成日 2024/07/04 6:09:55 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
製品変更通知	Änderung der Verpackung – 2762070000 USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK Change of packaging – 2762070000 USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK
カタログ	Catalogues in PDF-format

USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

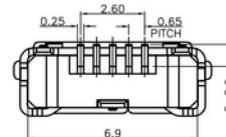
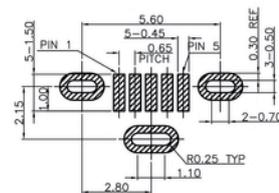
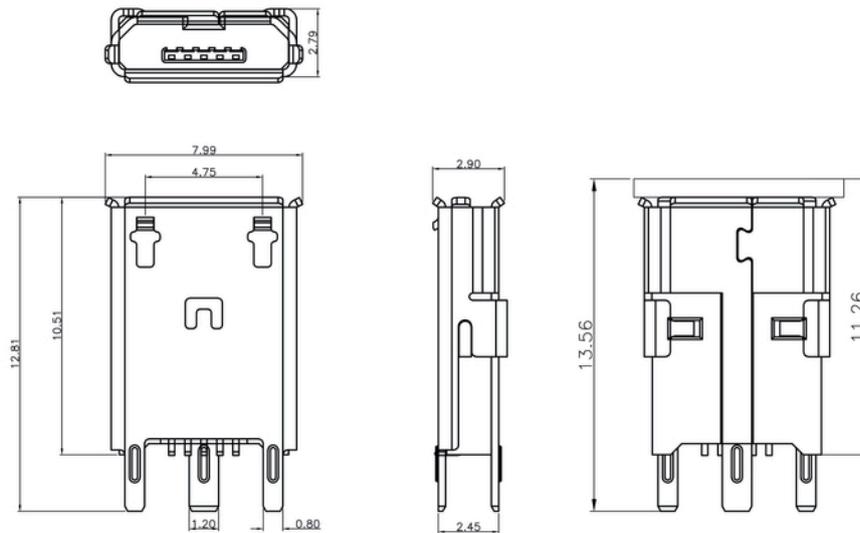


USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

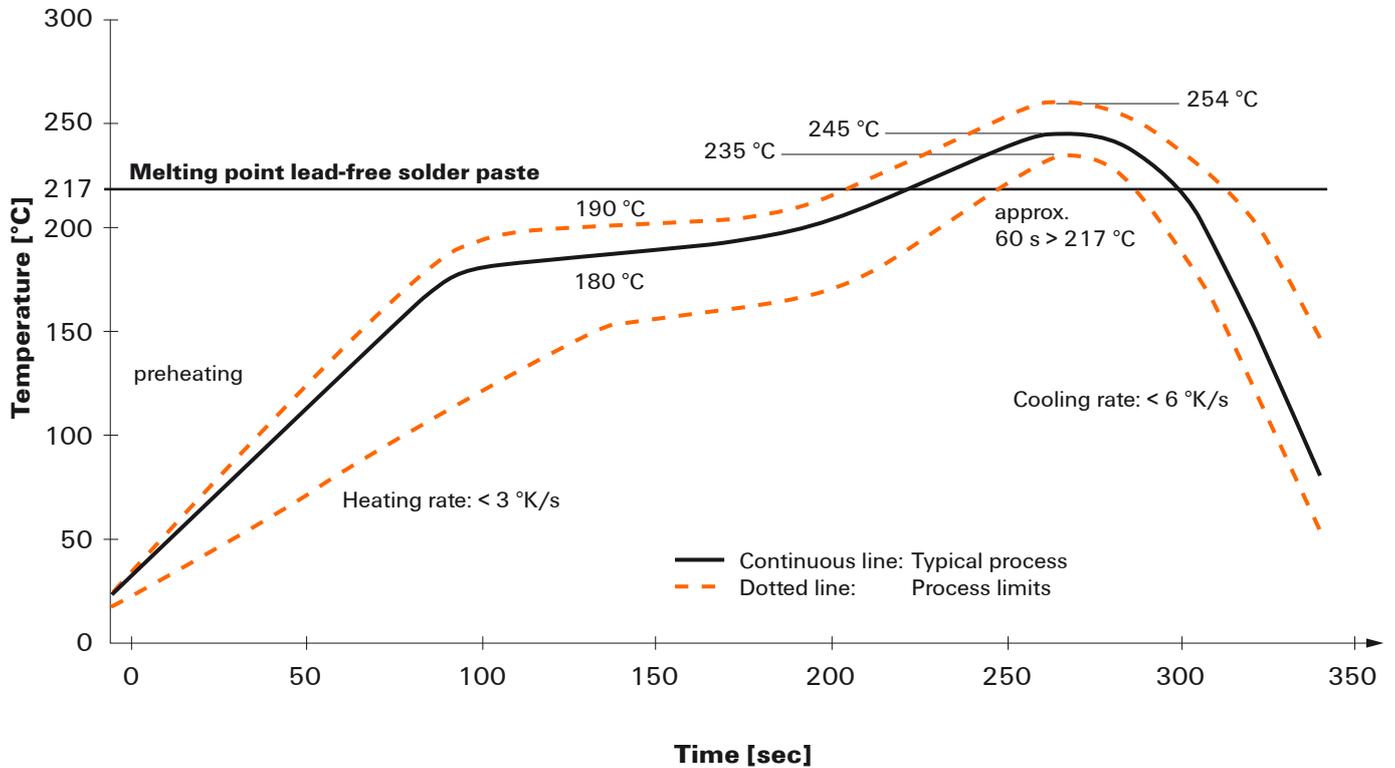
図面



RECOMMEND PCB LAYOUT (THICKNESS=1.6mm)
 TOLERANCE: ±0.05

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is ‚activated‘. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.